

WS488 SOLDADURA EN PASTA SOLUBLE EN AGUA

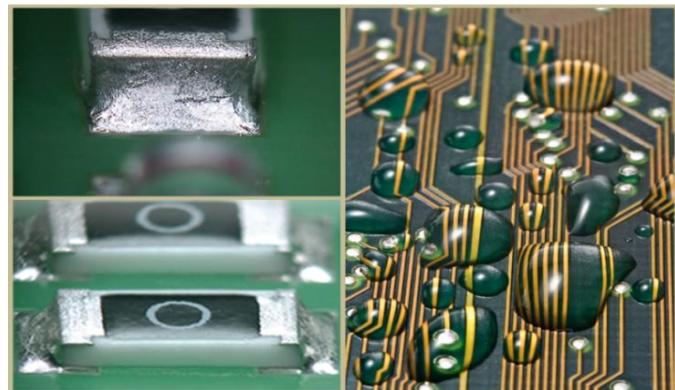
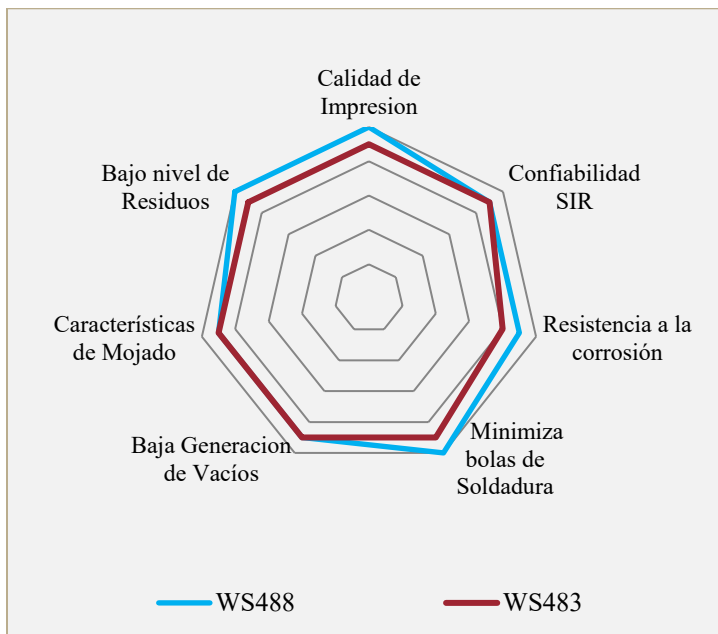
CARACTERÍSTICAS

- Excelente Humectación
- Amplio rango de Limpieza
- Excelentes Características de Impresión
- Vida en el Esténcil > 8 Horas
- Fácil Remoción con Agua
- Baja Generación de Espuma

DESCRIPCIÓN

La soldadura en pasta soluble en agua WS488 de AIM ha sido diseñada para ofrecer un potente rendimiento de humectación en todas las superficies, componentes, ensamblajes y sustratos electrónicos soldables. WS488 ofrece una gran tolerancia ambiental, excelentes características de impresión y más de 8 horas de vida útil del esténcil. La WS488 se ha desarrollado para ofrecer un rendimiento estable con todas las aleaciones con y sin plomo. Los residuos altamente solubles de la WS488 se eliminan fácilmente con agua corriente, incluso en componentes con baja separación. Este producto soluble en agua para todo uso se ha creado para satisfacer la demanda de la industria de una soldadura en pasta soluble en agua que ofrezca una confiabilidad constante.

CARACTERÍSTICAS



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Tiempo	Temperatura
Vida útil sellada y refrigerada	6 meses	0°C-12°C (32°F-55°F)
Vida útil sellada no refrigerada	2 semanas	< 25°C (< 77°F)

No agregue pasta usada al contenedor de pasta nueva. La pasta usada deberá ser almacenada por separado y la pasta nueva requiere un sellado hermético, ya sea con tapa interna o tapón. Una vez abierta, la vida útil de la soldadura en pasta dependerá de la aplicación y el entorno. Consulte la guía de manejo de pasta de AIM para más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de WS488 para información específica del producto.

LIMPIEZA

Pre-reflujo: El limpiador de estenciles de AIM elimina eficazmente la soldadura en pasta de los estenciles durante el proceso. El limpiador de estenciles se puede aplicar a mano o utilizar en equipos de limpieza bajo estencil. El limpiador de estenciles no seca la soldadura en pasta y mejora las propiedades de transferencia. No aplique una cantidad excesiva de limpiador de estenciles. No aplique el limpiador de estenciles en la parte superior del estencil. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) durante el proceso, pero se puede utilizar como enjuague final del estencil.

Residuos de flux posteriores al reflujo: AIM recomienda eliminar los residuos de flux solubles en agua en un plazo de 24 horas para obtener resultados óptimos, pero pueden dejarse en la placa de circuito hasta dos semanas. La limpieza puede realizarse con agua corriente a una temperatura de entre 50 °C y 60 °C (120 °F y 140 °F), seguida de un enjuague final con agua desionizada.

PERFIL DE REFLUJO

Document Rev #NF10
Page 1 of 3

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.


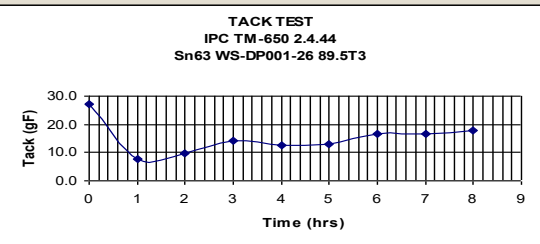

Toda la información del perfil se puede encontrar en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Póngase en contacto con AIM para obtener información adicional y/o soporte para su proceso.

IMPRESIÓN

Configuración Inicial Recomendada - Varía de acuerdo al tipo y diseño del PCB o pad	
Parámetro	Valor Inicial Recomendado
Presión de la espátula	0.10-0.30 kg/cm (.6 - 1.7 lbs/In.) de Navaja
Velocidad de la espátula	12-150 mm/sec (.5-6"/seg)
Distancia de Separación (Snap-off)	En contacto - 0.00 mm
Distancia de Desprendimiento entre PCB y estencil	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Desprendimiento entre PCB y estencil	Lento

DATOS DE PRUEBAS

Nombre	Método de Prueba	Resultado	
Clasificación de IPC	J-STD-004 versión actual	ORM1	
Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Prueba de Corrosión Inducida por el Método Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	M = < 50% de penetración	
Pruebas de Propiedades Corrosivas de los Residuos de Flux	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	Menor	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Antes</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Después</p>  </div> </div>
Contenido de Haluro(s) por Método de Cromatografía Iónica	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	0.07% típico	M1
Presencia de Haluro(s) por Método de Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	Haluros Presentes	

Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen																				
Presencia de Fluoruro(s) por Método de Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	Sin Fluoruros																					
Resistencia Aislante de la Superficie (SIR)	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	limpio																				
Índice de Acidez del Fundente	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	55.2 mg KOH/g Flux Típico																					
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	600-1000 Kcps típico																					
Inspección Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Café Oscuro																					
Prueba colapsamiento de la Soldadura en Pasta (slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASS																					
Prueba de Bolas de Soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASS																					
Fuerza de adhesión (Tack)	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	30.5 gf típico	 <p>TACK TEST IPC TM-650 2.4.44 Sn63 WS-DP001-26 89.5T3</p> <table border="1"> <caption>Tack Test Data</caption> <thead> <tr> <th>Time (hrs)</th> <th>Tack (gf)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>28</td></tr> <tr><td>1</td><td>10</td></tr> <tr><td>2</td><td>12</td></tr> <tr><td>3</td><td>15</td></tr> <tr><td>4</td><td>12</td></tr> <tr><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>6</td><td>18</td></tr> <tr><td>7</td><td>18</td></tr> <tr><td>8</td><td>19</td></tr> </tbody> </table>	Time (hrs)	Tack (gf)	0	28	1	10	2	12	3	15	4	12	5	13	6	18	7	18	8	19
Time (hrs)	Tack (gf)																						
0	28																						
1	10																						
2	12																						
3	15																						
4	12																						
5	13																						
6	18																						
7	18																						
8	19																						
Prueba de Mojado (Wetting)	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASS																					

*Con el fin de tener una calificación ORL0, la pasta de soldadura tiene que pasar SIR sin limpiar. Como WS488 es una química de pasta soluble en agua que requiere una limpieza, que tiene una clasificación de ORM1 para los estándares IPC.